

30.05.2024 – 10:36 Uhr

ERS electronic stellt vollautomatische Luminex-Maschinen mit photothermischem Debonding und Wafer-Reinigungsfunktion vor

München (ots/PRNewswire) -

[ERS electronic](#), der branchenführende Anbieter von Wärmemanagementlösungen für die Halbleiterfertigung, kündigt zwei neue vollautomatische Maschinen aus seiner Luminex-Produktlinie an. Die Maschinen [LUM300A1](#) und [LUM300A2](#) sind für 300-mm-Substrate ausgelegt und verfügen beide über die hochmoderne [photothermische Debonding](#)-Technologie von ERS, die unvergleichliche Flexibilität, Kosteneffizienz und Durchsatz für temporäre Klebe- und Debonding-Prozesse bietet.

„Temporäres Bonding und Debonding ist eine unverzichtbare Technik für zuverlässiges Ausdünnen und Packaging von Substraten (Wafer oder Panels)“, erklärt Taguhi Yeghoyan, PhD. Leiter für Technologie & Marktanalyse, Halbleiterausrüstung bei der Yole Group. „Unter allen Anwendungen treiben die jüngsten Fortschritte im Verpackungsbereich, wie z. B. Fan-out-Panel-Level-Packaging und heterogene Integration, den Umsatz mit temporären Bonding- und Debonding-Geräten an, der 2029 voraussichtlich 571 Mio. US-Dollar erreichen wird, mit einem CAGR von +16,6 % zwischen 24 und 29 Jahren, wobei mehr als 70 % des Umsatzes mit laserbasierten Maschinen erzielt werden.“[1]

Die neuen Luminex-Maschinen von [ERS](#) bieten eine einzigartige Lösung für spannungsfreies Debonding und sparen im Vergleich zum herkömmlichen Laser-Debonding mehr als 30 % der Betriebskosten. Sie sind so konstruiert, dass sie auch dünne Wafer problemlos handhaben können. Die Maschinen haben einen Durchsatz von mehr als 45 Wafern pro Stunde und bieten eine ertragreiche Lösung, die die Produktivität erheblich steigert.

Ein entscheidender Vorteil des [photothermischen Debonding](#)-Verfahrens ist seine Kompatibilität mit einer Vielzahl von Bondingmaterialien und Lieferanten, wodurch die Maschinen die hohe Produktvariabilität von OSATs abdecken und sich nahtlos in verschiedene Fertigungsabläufe integrieren lassen.

Während [LUM300A1](#) eine großvolumige Lösung für den Debonding-Prozess bietet, beinhaltet [LUM300A2](#) ein Wafer-Reinigungsmodul, um Klebereste vom Wafer zu entfernen.

„Unsere Luminex-Maschinen erhöhen die Flexibilität und Effizienz des Debonding-Prozesses erheblich und ermöglichen es unseren Kunden, die Entwicklung von Halbleiterchips der nächsten Generation für KI, Automotive und andere innovative Anwendungen zu beschleunigen“, sagt Debbie-Claire Sanchez, Vizepräsidentin und Managerin der Geschäftseinheit Advanced Packaging Equipment bei [ERS electronic](#).

Die halbautomatische Version [LUM600S1](#) für Wafer und Panels bis 600 x 600 mm wurde im März auf den Markt gebracht und steht in den Kompetenzzentren von ERS in China und Deutschland für Tests und Evaluierungen zur Verfügung.

1. Quelle: [Wafer Fab Equipment Market Monitor](#), Yole Intelligence, 2024.

Informationen zu ERS:

ERS electronic GmbH mit Sitz in der Nähe von München bietet seit mehr als 50 Jahren innovative Wärmemanagement-Lösungen für die Halbleiterindustrie. Einen hervorragenden Ruf hat sich das Unternehmen mit seinen Thermospannsystemen für die analytische, parameterbezogene und fertigungstechnische Prüfung erworben. Im Jahr 2008 hat ERS sein Know-how auf den Markt für Advanced Packaging ausgeweitet. Heute sind seine vollautomatischen und manuellen Systeme für Debonding und Verformungsausgleich in den Produktionshallen der meisten Halbleiterhersteller und OSATs weltweit zu finden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2424346/ERS_Luminex.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1801970/ERS_electronic_GmbH_Logo.jpg

View original content: <https://www.prnewswire.com/news-releases/ers-electronic-stellt-vollautomatische-luminex-maschinen-mit-photothermischem-debonding-und-wafer-reinigungsfunktion-vor-302159184.html>

Pressekontakt:

Sophia Oldeide,
oldeide@ers-gmbh.de,
+49 8989 4132-143

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100089895/100919954> abgerufen werden.